

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211110

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	景林资产：蒋彤、孙玮、蒋文超；申万宏源：胡双；凯石基金：陈晓晨；肇万资产：崔磊；四季资产：尹勇；无锋基金：陈净；思加资本：王远洋；四季资本：高翔；全天候基金：曾雨；高国志等 12 名投资者及证券人员
时间	2021 年 11 月 9 日下午 13:30-15:50
地点	公司 516 会议室
上市公司接待人员姓名	董事长朱双全、董事会秘书杨平彩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体工艺、显示材料业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司在半导体制程工艺、显示材料领域有怎样的愿景？</p> <p>答：鼎龙致力于成为国际国内领先的关键大赛道领域中相关核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目标在每年都推出至少一款处于验证或放量阶段的材料新品。其中：CMP 抛光垫是我们已经推出的首款成熟的半导体材料，目前收入和利润都在快速增长；YPI 进入放量阶段、清洗液预计明年开始放量、PSPI 和 INK 中试验证进度符合预期，这些材料预期在明年都会有比较明显的进展。</p> <p>问 2：公司选择布局的几款材料都有哪些特点？</p> <p>答：鼎龙开始一个新材料项目前会对自身技术特点、市场规模与态势、行业竞争情况做全面的评估，确保公司的研发投入能在一定周期内转化为技术储备、打开新的产品布局和盈利增长点。其中：①技术特点方面，要与鼎龙二十多年积累的研发实践存在共性，能借助鼎龙七大技术平台的研发优势，实现研发团队的平移打通，快速高效地推动研发进度；②市场规模方面，国内要拥有巨大的自主化替代空间，国内市场需求规模在 10 亿元以上，且整个行业处于高速发展的态势；③竞争情况方面，细分领域竞争不拥挤，且公司有信心成为国内唯一或者开发验证进度领先的供应商。公司正在布局的多款材料都符合以上几个特点。</p>

问 3：公司 CMP 抛光垫业务在国内市场的地位是怎样的？

答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫供应商，抛光垫产品在国内主流核心晶圆厂稳步放量，并已成为部分客户的第一供应商。目前 CMP 抛光垫业务进入持续稳步增长的阶段，收入利润季度环比增幅持续显著，在该领域国内市场的优势地位已经确立，并在不断巩固。

问 4：公司如何看待国内 CMP 抛光垫领域未来可能的竞争？

答：CMP 抛光垫具有高门槛、技术密集、资金密集、客户验证壁垒高的特点，初创型公司进入这个领域会面临很大的困难，具备一定技术和资金实力的公司也需要较长的研发、验证周期。公司是在 2012 年启动 CMP 抛光垫的研发，在 2017 年获得首张订单，在 2019 年获得首张 12 寸订单，并抓住了集成电路产业供应链自主化替代大趋势，才逐步进入国内各家主流晶圆厂，并发展成部分客户的第一供应商。现阶段公司已经确立在 CMP 抛光垫领域国内市场的优势地位，在各个方面具备核心竞争力，所以有信心在一段时间内保持 CMP 抛光垫业务的高速发展，深化和巩固公司在该领域的竞争优势地位。

问 5：公司在 CMP 抛光垫领域有哪些优势或核心竞争力？

答：公司 CMP 抛光垫的产品优势、配套服务优势推动公司抛光垫产品在客户端持续快速放量，供应链优势保证公司在可能的市场竞争中占据优势地位。具体来看：①产品优势：公司成熟制程 CMP 抛光垫产品型号覆盖率接近 100%，先进制程抛光垫持续配合客户进行研发与验证，产品质量与研发能力获得客户的良好反馈；②：配套服务优势：公司能解决客户在产品使用中偶发的问题，提供应用评价、设备支持等方面的服务；③供应链优势：公司持续提升抛光垫业务供应链管理水平和通过持续评估开发供应商、推动部分核心原材料的自研自产，保障了原材料供应的抗风险能力、自主安全性，并优化了成本结构。

问 6：公司如何看待 CMP 抛光垫国内的市场规模情况？

答：CMP 抛光工艺是集成电路制造过程中晶圆表面平坦化的关键工艺，而 CMP 抛光垫是 CMP 抛光工艺中的核心耗材之一。随着国内集成电路产业持续高速发展、晶圆厂大规模资本建设持续投入，以及集成电路制造技术不断升级带来的抛光次数的增加，CMP 材料的市场空间将会持续扩容，所以我们对市场未来的增速是比较看好的。

问 7：公司半导体显示材料板块布局了哪些材料？

答：在半导体显示材料领域，公司对标国外龙头面板材料企业，布局多款技术难度高的卡脖子显示材料，其中：①柔性显示面板基材 YPI 浆料是目前最成熟的一款材料，已经进入了批量放量阶段；②OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 在客户端验证，测试反馈符合预期；③OLED 触控保护层低温 OC 等其他显示材料的研发按进度推进中。

	<p>问 8: 公司柔性显示材料 YPI 产品的市场规模和放量进度有怎样的预期?</p> <p>答: 柔性 OLED 手机渗透率持续提升, AMOLED 基材 PI 浆料的市场规模保持增长趋势, 在行业需求扩张和已交付产品反馈良好的推动下, 客户订单会逐渐增加, 明年开始公司 YPI 产品的销售收入较今年会有较为明显的提高。作为国内唯一实现 YPI 产品在国内主流面板厂 G6 代线验证通过、唯一拥有 YPI 产品千吨级产线的企业, 公司有决心在国内主流面板客户端逐步放量, 并成为部分国内主流面板厂的第一供应商。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 9 日